

Quiz 1 – Microelectrónica

Estudiante; Genesis Ortega 8-913-12

¿Qué sale más barato comprar en compañías como Mouser?

BQ500211RGZT

BQ500212ARGZR

BQ500211ARGZT

BQ500211ARGZR

En que proceso se expone el material a luz ultravioleta

Metalización

Empacado

Difusión

Implantación de Iones

Fotolitografía

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

Un encapsulado SOT-323 tiene:

3 terminales de E/S

4 terminales de E/S

5 terminales de E/S

6 terminales de E/S

Una resistencia de 470 Ohms 10% de tolerancia tendrá las siguientes franjas

Amarillo, Verde, Negro, Oro

Amarillo, Verde, Negro, Plata

Amarillo, Gris, Negro, Oro

Amarillo, Violeta, Chocolate, Plata

Qué componentes de los siguiente son necesarios para realizar un cargador Qi WPC

Bq5002a

Bq5103a

Bq1010b

Bq500511

Mandatoriamente un microcontrolador con interfaz I2C

Los componentes BGA son los únicos con conexiones en la superficie interna

Sí

No

En que proceso se alcanza mayor temperatura

Deposición de vapor químico

Implantación de lones

Oxidación

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

Orden del proceso de desarrollo de un IC:

Preparación de la oblea, Difusión, Oxidación, Implantación de lones, Deposición de vapor químico, Metalización, Fotolitografía, Empacado

Preparación de la oblea, Oxidación, Difusión, Deposición de vapor químico, Implantación de lones, Metalización, Fotolitografía, Empacado

Preparación de la oblea, Oxidación, Difusión, Implantación de lones, Deposición de vapor químico, Metalización, Fotolitografía, Empacado

Preparación de la oblea, Oxidación, Difusión, Implantación de lones, Deposición de vapor químico, Metalización, Empacado, Fotolitografía

Los componentes en el proceso microelectronico se dopan con:

iones n

iones p

iones npn

iones pnp

A y B

B y C

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

Un componente Flat 1210 en sistema inglés equivale a:

3.2 x 2.6 mm en SI

3.2 x 2.5 mm en SI

4.5 x 3.2 mm en SI

2.5 x 3.2 mm en SI